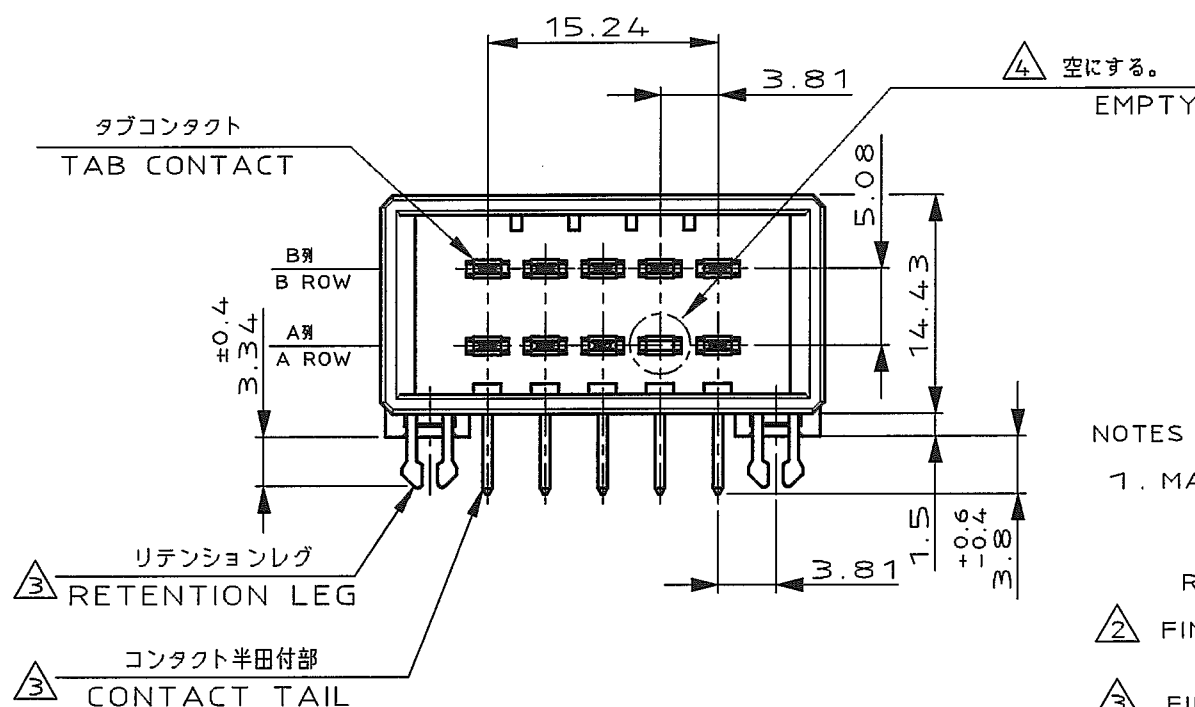
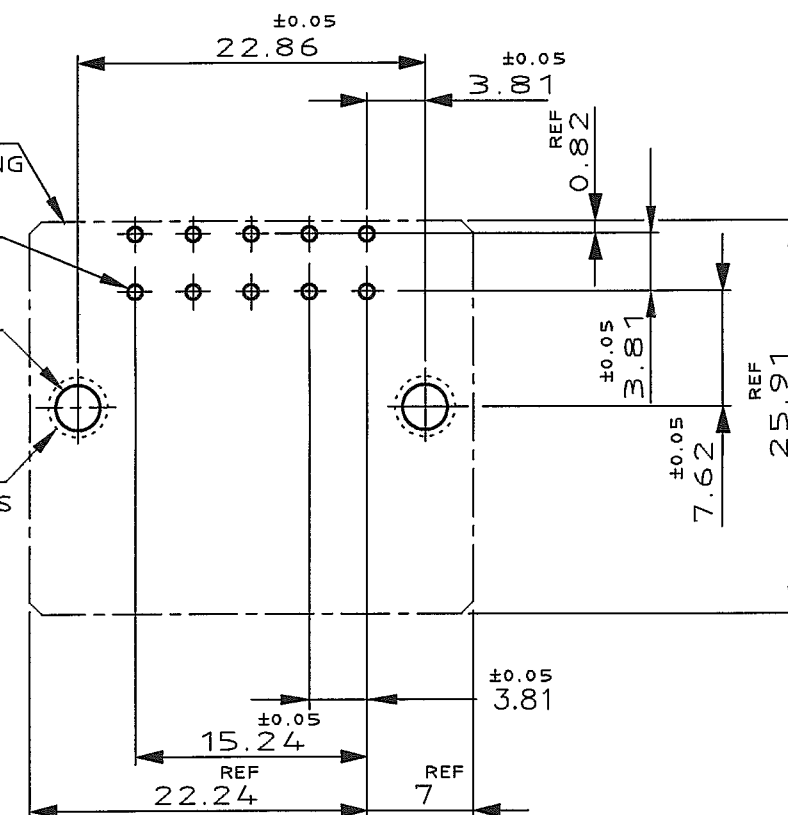
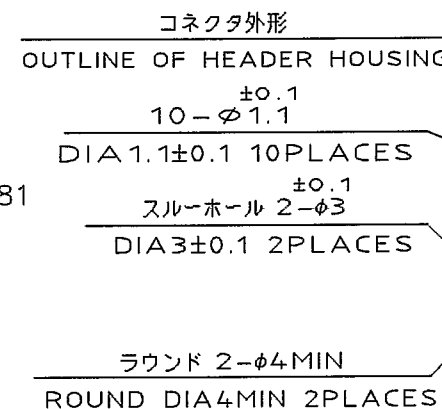
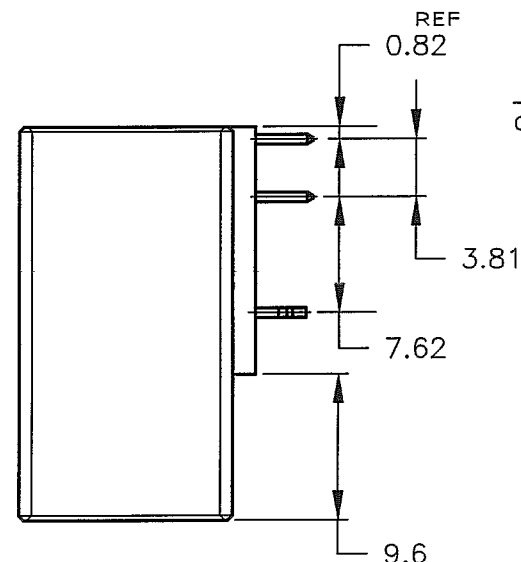
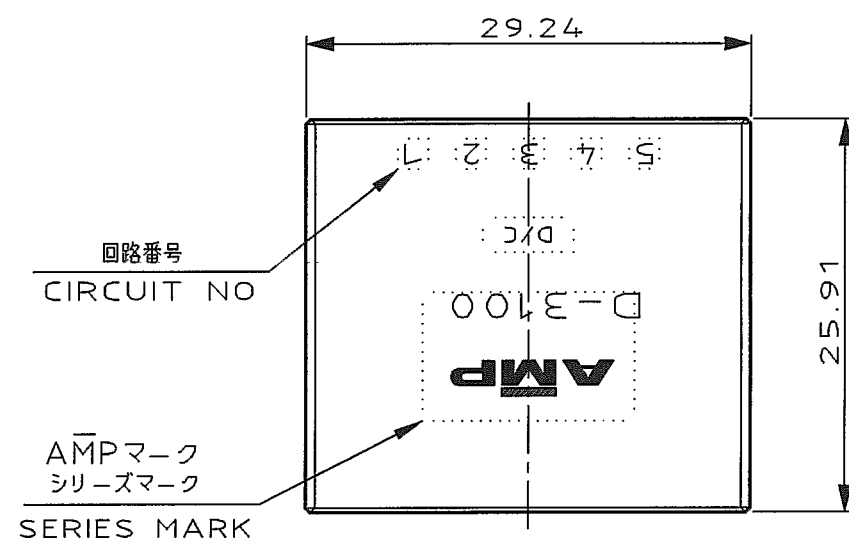




推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO
PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μ MMIN TIN
PLATED OVER NICKEL
3. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
4. CURCUIT NO.4 OF A ROW: EMPTY

注記

7. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト：銅合金
リテンションレグ：銅合金
めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：2.0 μm MINスズめっき
めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部
：ニッケル下地の上にスズめっき

△ 3 △ 2	179613-5
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)

			Copyright ©1994年 日本エー・エム・ピー株式会社			Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			 Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
			結合電線断面図 (WIRE RANGE)			被覆外径 (INSULATION DIA.)			名称 (NAME)		
			mm? (AWG -)			mmφ			10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 310		
			材料 (MATERIAL) 注記参照 SEE NOTE			仕上 (FINISH) 注記参照 SEE NOTE			一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
A REVISED (FJD0-0114-03) T.S. S.M. 4/25/83			DR. 28/JAN/94 K.IKEDA			DE. 28/JAN/94 K.IKEDA			10mm ±0.35 10mm以下 ±0.4 30mm以下 ±0.45 角 度 ±3°		
O RELEASED (FJ00-0084-94) K.I. S.M. 2/FEB/94			CHK. 2/FEB/94 S.MANABE			APP. 2/FEB/94 S.MANABE			位置公差 (LOCATION TOL.) 穴 径 ±0.05 穴 位置 ±0.1 面 度 ±0.1 面 位置 ±0.1		
LTR 変更 (REVISION RECORD)			DR CHK DATE						公差 (TOLERANCE) 位置公差 (LOCATION TOL.) 穴 径 ±0.05 穴 位置 ±0.1 面 度 ±0.1 面 位置 ±0.1		